

锦州神工半导体股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2026年7月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于拟投资建设新项目的议案》

董事会认为：本次开展新项目是基于公司长期发展的战略规划，有助于强化公司核心竞争力并优化公司业务结构，可以满足公司长期发展及生产经营需要，进一步提升公司产业化能力和综合竞争力。本项目拟投资总额约为112,992.14万元人民币（以实际投入为准）。

该事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及管理层在符合相关法律法规、规范性文件及公司章程规定、不改变项目核心投资方向的前提下，结合项目实际推进情况、市场环境变化、公司资金储备状况、整体战略布局及再融资募投项目实施节奏，全权办理本次投资项目的全部相关事宜（包括但不限于：调整项目的投资节奏、分期投入计划与具体投资金额等事项）。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于公司拟投资建设新项目的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 8 日